

杭州士兰微电子股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“投资双方”）于 2017 年 12 月 18 日在中国厦门共同签署了《关于 12 吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。公司于 2018 年 1 月 11 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与厦门半导体投资集团有限公司签署〈关于 12 吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》。根据《投资合作协议》，投资双方于 2018 年 2 月成立了项目公司厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）。双方合作在厦门市海沧区建设的第一条 12 吋产线，总投资 70 亿元，其中一期总投资 50 亿元，项目二期总投资 20 亿元。

上述事项详见公司于 2017 年 12 月 19 日、2018 年 1 月 12 日和 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的相关公告，公告编号为临 2017-067、临 2018-001 号和临 2018-010。

二、投资标的的基本情况

截至本公告披露日，厦门士兰集科微电子有限公司的基本情况如下：

- 1、类型：法人商事主体（其他有限责任公司）
- 2、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 03 单元 F0060
- 3、法定代表人：王汇联
- 4、注册资本：贰拾伍亿零肆拾玖万元整
- 5、成立日期：2018 年 2 月 1 日
- 6、营业期限：2018 年 2 月 1 日至 2068 年 1 月 31 日

7、经营范围：集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）。

8、股东情况：厦门半导体投资集团有限公司持有其 85% 股权，本公司持有其 15% 股权。

9、截止 2020 年 12 月 31 日，士兰集科经审计的总资产为 382,247 万元，负债为 138,299 万元，净资产为 243,948 万元。2020 年度净利润为-3,833 万元。士兰集科 2020 年尚处于建设期，未有主营业务收入。

截止 2021 年 3 月 31 日，士兰集科未经审计的总资产为 407,496 万元，负债为 167,587 万元，净资产为 239,909 万元。2021 年 1-3 月营业收入为 6,510 万元，净利润为-4,039 万元。

三、投资进展情况

2020 年，士兰集科第一条 12 吋芯片生产线第一期项目已实现通线，并在 2020 年 12 月实现正式投产。预计今年四季度士兰集科将实现月产 12 吋片 3 万片的目标。当前，集成电路芯片及功率器件市场面临良好的发展机遇，士兰集科很有必要在完成第一期投资 50 亿元的基础上，进一步增加投入，尽快扩大产能。根据《投资合作协议》，士兰集科于近日启动了第一条 12 吋芯片生产线“新增年产 24 万片 12 英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”，该项目主要内容为：在士兰集科现有的 12 吋集成电路芯片厂房内，通过增加生产设备，配套动力及辅助设备设施建设，以及净化车间装修等，实现新增年产 24 万片 12 英寸高压集成电路和功率器件芯片生产能力。该项目总投资为 20 亿元，实施周期为 2 年。

士兰集科“新增年产 24 万片 12 英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”已于 2021 年 5 月 11 日取得了《厦门市企业投资项目备案证明》（编号：厦海工信投备（2021）190 号）。该项目的实施有利于加快推动士兰集科 12 吋集成电路芯片生产线的建设和运营，进一步提升制造工艺水平，对公司

的经营发展具有长期促进作用。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2021年5月12日